享受《若干政策》第（一）条的集成电路

生产企业或项目申报材料目录

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **材料** |
| 1 | 系统生成纸质文件 |
| 2 | 企业情况说明（参考模板1） |
| 3 | 企业法人营业执照副本 |
| 4 | 企业取得的其他相关资质证书（可提供相应查询网址） |
| 5 | 项目备案文件（备案表）（可提供相应查询网址） |
| 6 | 企业承诺书（系统下载） |
| 7 | 企业职工人数、学历结构、研发人员情况及其占职工总数的比例说明（参考模板2） |
| 8 | 研发人员名单（参考模板3） |
| 9 | 汇算清缴年度最后一个月企业职工社保证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证） |
| 10 | 企业主要工艺、产品列表（名称/规格）（参考模板4） |
| 11 | 企业拥有与主营产品相关的专利列表（参考模板5）及对应证书 |
| 12 | 2022年度会计审计报告 |
| 13 | 2022年度专项审计报告（如审核指标已体现在企业会计审计报告中，可无需另外提供） |
| 14 | 与主要客户签订的两份代表性销售合同复印件 |
| 15 | 企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等）（参考模板6） |
| 16 | 市发改委（市工信局）要求出具的其他材料 |

纸质材料装订建议

1. 按照材料目录顺序胶装，并用彩页隔开各项内容；

2. 如有特殊情况，请附上加盖公章的情况说明；

3. 封面及书脊注明“申报年度+类别+公司名称”（如:2022年度享受《若干政策》第（一）条的集成电路线宽小于28 纳米（含）的集成电路生产企业：XX公司）；

4．封面上留下联系人及联系电话；

5. 如分册装订，请注明“共XX册，第XX册”；

电子光盘按材料类别建立文件夹，以材料名称命名文件名（如一、系统生成的纸质文件），审计报告及专项审计报告、测试报告、合同等涉及多页的文档按份扫描成PDF格式（不要一张一个图片或者文件）。

**参考模板1**

**XXX公司情况说明**

提纲（包括但不限于）：

一、企业业务简介

从公司成立背景、核心技术、主要产品、业务特点、主要客户或服务对象、商业模式等方向进行简要描述。

二、其他需要说明的事项

联系人/职务/手机：

公司名称（盖章）：

年 月 日

**参考模板2**

**XXX公司人员构成情况说明**

企业从事8英寸及以下集成电路生产（**注意：如果未从事8英寸及以下生产，删掉此句即可**）。

2022年，具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系，企业月平均职工总人数为 人，其中具有本科及以上学历的月平均职工人数为 人，占当年月平均职工总人数的比例为 %。

2022年，具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系，企业研究开发人员月平均数为 人，占当年月平均职工总人数的比例为 %，其中本科及以上学历的研发人员月平均人数为 人，占当年月平均职工总人数的比例为 %。

2022年12月企业缴纳社会保险人员（包括劳务派遣人员代缴社保） 人，其中劳务派遣人员代缴社保人数为 人。

说明：

1、月平均人数计算：月平均数=（月初数+月末数）÷2；

2、年度月平均数=全年各月平均数之和÷12

公司名称（盖章）：

年 月 日

**参考模板3**

**研发人员名单**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **岗位** | **学历** | **毕业院校** | **专业** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：①表格内仅填写汇算清缴年度最后一个月的人员情况；②研发人员主要包括研究人员、技术人员和辅助人员。**

**参考模板4**

**企业主要工艺、产品列表**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工艺、产品名称** | **工艺、产品规格** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：工艺部分填写时需要体现具体线宽，例如：28nm FinFET工艺**

**参考模板5**

**企业拥有与主营产品相关的专利列表**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利类型** | **专利名称** | **专利号** | **专利申请时间** | **专利授权时间** | **专利有效期** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：①表格内填写的专利，应为企业以此为基础开展经营活动；②专利列表中必须包含企业拥有的与主营产品相关的发明专利等；③企业提供的专利证明材料，应与表格保持一致。**

**参考模板6**

**企业具有保证产品生产的手段和能力证明材料**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **提供商/国别** | **设备型号** | **数量（台/套）** | **自购/租用** |
| **一、硬件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、软件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **三、场地** | | | | | |
| **位置** |  | | **面积** |  | |

**注：除上表外，还需提供具有保证产品生产手段和能力的文字简述（包括但不限于研发及生产水平，具有保证相关工艺线宽产品生产的手段和能力，结合软硬件设备对产品研发生产手段和能力介绍）、软硬件设备及研发生产场地照片、采购合同等证明材料。**